

## New Metal-Shell Micro Circular Connector

The first half of this Document is English version and the second half is Japanese.

この製品規格書の前半は英語記述であり、後半は日本語記述となっております。

English / 英語 1 ~ 8 P

Japanese / 日本語 9 ~ 16P

### 1. INTRODUCTION

#### 1.1 Purpose

Testing was performed on the Tyco Electronics New Metal-Shell Micro Circular Connector to determine its conformance to the requirements of Product Specification 108-78967 Revision A.

#### 1.2. Scope

This report covers the electrical, mechanical, and environmental performance of the New Metal-Shell Micro Circular Connector.

#### 1.3. Conclusion

The New Metal-Shell Micro Circular Connector listed in paragraph 1.5., conformed to the electrical, mechanical, and environmental performance requirements of Product Specification 108-78967 Revision A.

#### 1.4. Product Description

This system is used primarily in industrial, commercial and military applications where durability and reliability are of primary concern. Shell size M15 accommodates 14 contacts maximum while shell size M22 accommodates 30 contacts maximum. The configuration of contacts is a hybrid of signal and power contacts.

The system is sealed to level IP67 and is available in wire-to-wire, wire-to-panel, and wire-to-board configurations.

Plugs incorporate solder cup terminals which will accommodate as below.

14 contacts : Signal=AWG24 (19 strands)  
Power=AWG20 (19 strands)

30 contacts : Signal=AWG24 (19 strands)  
Power=AWG22 (19 strands)

### 1.5. Test Specimens

Test Specimens were representative of normal production lots. Specimens identified with the following part numbers were used for test:

Product Part No.	Description
2201481-1, -2	Bayonet 14P Plug Pin Socket Connector / Solder Cup Cont KIT
2201482-1	Bayonet 14P Rece Pin Socket Connector / Solder Tail Cont KIT
2201712-1, -2	Thread 30P Plug Pin Socket Connector / Solder Cup Cont KIT
2201713-1	Thread 30P Rece Pin Socket Connector / Solder Tail Cont KIT

#### Appendix 1

### 1.6. Environmental Conditions

Unless otherwise stated, the following Environmental Conditions prevailed during testing:

- Temperature: 15 to 35°C
- Relative Humidity: 25 to 75%

1.7. Product Qualification Test Sequence

Test Examination	Test Group									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Test Sequence (b)									
Examination of Product	1,8	1,4	1	1	1	1	1	1	1	1
LLCR	2	2	2,4					2,4		2,4
Insulation Resistance				2,6						
Withstanding Voltage				3,7						
Shell to Shell Conductivity	3,9									
Shielding Effectiveness						2				
Solder ability (Dip Test)					2					
Durability	6						3			
Sinusoidal Vibration	4									
Mechanical Shock	5									
Cold Resistance								3		
Temperature Life (Heat Aging)		3								
Thermal Shock				4						
Humidity / Temperature Cycling				5						
Water Proof							2,4			
Pressure Test (Sealing)									2	
Mixed Flowing Gas			3							
Salt Spray	7									
Temperature Rising										3
Final Examination of Product	10	5	5	8	3	3	5	5	3	5

Fig. 2

NOTE

(a) Numbers indicate sequence in which tests are performed.

## 2. SUMMARY OF TESTING

### 2.1 Examination of Product - All Test Groups

All specimens submitted for testing were representative of normal production lots. A Certificate of Conformance was issued by Product Assurance. Specimens were visually examined and no evidence of physical damage detrimental to product performance was observed.

### 2.2. Contact Resistance (Low Level) - Test Groups 1, 2, 3 and 8

All specimens were measured LLCR, taken at 100mA maximum and 20mV Maximum open circuit voltage were less than 30m $\Omega$  after testing.

### 2.3. Insulation Resistance - Test Group 4

All Insulation Resistance measurements were greater than 5000M $\Omega$  initially and 1000M $\Omega$  after testing.

### 2.4. Withstanding Voltage - Test Group 4

No dielectric breakdown or flashover occurred.

### 2.5. Shell to Shell Conductivity - Test Group 1

All Voltage drop measurements were less than 20mV.

### 2.6. Shielding Effectiveness - Test Group 6

Radiation was reduced a minimum of 30dB.

### 2.7. Solder ability (Dip Test) - Test Group 5

Solder able areas had a minimum of 95% solder coverage.

### 2.8. Durability - Test Groups 1 and 7

No physical damage occurred as a result of mating and un-matching for 2000 cycles.

### 2.9. Sinusoidal Vibration - Test Group 1

No discontinuities were detected during vibration testing. Following vibration testing, no cracks, breaks, or loose parts on the specimens were visible.

### 2.10. Mechanical Shock - Test Group 1

No discontinuities were detected during Mechanical Shock testing. Following Mechanical Shock testing, no cracks, breaks, or loose parts on the specimens were visible.

2.11. Cold resistance – Test Group 8

No evidence of physical damage was visible as a result of Cold Testing.

2.12. Temperature Life - Test Group 2

No evidence of physical damage was visible as a result of temperature life testing.

2.13. Thermal Shock - Test Group 4

No evidence of physical damage was visible as a result of Thermal Shock testing.

2.14. Humidity/temperature Cycling - Test Group 4

No evidence of physical damage was visible as a result of Humidity/Temperature Cycling.

2.15. Water Proof - Test Group 7

There was no evidence of water leakage as a result of immersion testing.

2.16. Pressure Test - Test Group 8

There was no evidence of air leakage as a result of blow compressed air testing.

2.17. Mixed Flowing Gas - Test Group 3

No evidence of physical damage was visible as a result of exposure to the pollutants of Mixed Flowing Gas.

2.18. Salt Spray - Test Group 1

There was no evidence of corrosion as a result of exposure to a 5% salt atmosphere.

2.19. Temperature Rising - Test Group 10

Differential temperature were less than 30°C as a result of energized specified current.

2.20. Final Examination of Product - All Test Groups

Specimens were visually examined and no evidence of physical damage detrimental to product performance was observed.

### 3 TEST METHODS

#### 3.1 Initial Examination of Product

A Certificate of Conformance was issued stating that all specimens in this test package were produced, inspected, and accepted as conforming to product drawing requirements, and were manufactured using the same core manufacturing processes and technologies as production parts.

#### 3.2. Contact Resistance (Low Level)

LLCR measurements were made using a 4 terminal measuring technique. The test current was maintained at 100mA maximum with a 20mV maximum open circuit voltage.

#### 3.3. Insulation Resistance

Insulation resistance was measured between adjacent contacts of mated specimens. A test voltage of 500V DC was applied for 2 minutes before the resistance was measured.

#### 3.4. Withstanding Voltage

A test potential of 500V AC was applied between the adjacent contacts of mated specimens. This potential was applied for 1 minute and then returned to zero.

#### 3.5. Shell to Shell Conductivity

Voltage drop across mated specimens was measured using  $1.0 \pm 0.1$ A DC at 1.5V.

#### 3.6. Shielding Effectiveness

The radiated response from unshielded cable while conductors were excited between 200MHz and 1GHz, was measured. The procedure was repeated, using jacks and plugs terminated to shielded cable.

The difference in response is the Shielding Effectiveness in dB.

#### 3.7. Solder ability (Dip Test)

Specimens were steam aged for 8 hours suspended in a closed container 2 inches above boiling de-ionized water. Specimens were immersed in a non-activated water white rosin maintained at room ambient for 5 to 10 seconds and allowed to drain for 5 to 20 seconds. Specimens were attached to a dipping machine and immersed at a rate of approximately 1 inch per second into a 60Sn/40Pb soldering bath controlled at  $245 \pm 5$ °C until the entire surface to be evaluated was coated. Specimens were held in the solder bath for 4 to 5 seconds, then removed at a rate of approximately 1 inch per second and cleaned for 5 minutes using isopropyl alcohol before being examined using 10X magnification.

#### 3.8. Durability

Mated and unmated specimens for 2000 cycles for pin & socket products at a maximum rate of 500 cycles per hour.

### 3.9. Sinusoidal Vibration

Mated specimens were subjected to sinusoidal vibration, having a simple harmonic motion with an amplitude of 0.06 inch double amplitude. The vibration frequency was varied uniformly between the limits of 10 and 55Hz and returned to 10Hz in 1 minute. This cycle was performed 2 hours in each of 3 mutually perpendicular planes for a total vibration time of 6 hours. Specimens were monitored for discontinuities of 1 microsecond or greater using a current of 100mA DC.

And additional test : Mated specimens were subjected to sinusoidal vibration, having a simple harmonic motion with an amplitude of 0.06 inch double amplitude. The vibration frequency was varied uniformly between the limits of 10 and 2000Hz and returned to 10Hz in 1 minute. This cycle was performed 4 hours in each of 3 mutually perpendicular planes for a total vibration time of 12 hours. (only Pin Socket products)

### 3.10. Mechanical Shock

Mated specimens were subjected to a Mechanical Shock test having a half-sine waveform of 50 gravity units (g peak) and a duration of 11 milliseconds. Three shocks in each direction were applied along the 3 mutually perpendicular planes for a total of 18 shocks. Specimens were monitored for discontinuities of 0.1 microsecond or greater using a current of 100mA DC.

### 3.11. Cold Resistance

Mated specimens were subjected at -55°C environment for 96 hours.

### 3.12. Temperature Life (Heat Aging)

Mated specimens were exposed to a temperature of 150 °C for 500 hours. Specimens were preconditioned with 10 cycles of durability.

### 3.13. Thermal Shock

Mated specimens were subjected to 5 cycles of Thermal Shock with each cycle consisting of 30 minute dwells at -55 and 150°C. The transition between temperatures was less than 1 minute.

### 3.14. Humidity/Temperature Cycling

Mated specimens were exposed to 10 Humidity/Temperature Cycles. Each cycle lasted 24 hours and consisted of cycling the temperature between 25 and 65°C twice while maintaining high humidity.

### 3.15. Water Proof

Mated and Unmated specimens were immersed in water to a depth of 1 meter for 30 minutes.

### 3.16. Pressure Test (Sealing)

Blow compressed air at 14.7kPa (0.15kgf/ cm<sup>2</sup>) into cable end for 30 sec.

### 3.17. Mixed Flowing Gas, Class IIA

Mated specimens were exposed for 20 days to a Mixed Flowing Gas Class IIA exposure. Class IIA exposure is defined as a temperature of 30°C and a relative humidity of 75% with the pollutants of Cl<sub>2</sub> at 10 ppm, NO<sub>2</sub> at 200 ppm, H<sub>2</sub>S at 10 ppm and SO<sub>2</sub> at 100 ppm. Specimens were preconditioned with 10 cycles of durability.

### 3.18. Salt Spray

Mated specimens were subjected to a 5% salt spray environment for 120 hours. The temperature of the box was maintained at 35°C +2/-3°C, while the pH of the salt solution was between 6.5 and 7.2.

### 3.19. Temperature Rising test

Temperature rising was measured by energized specified current.

### 3.20. Final Examination of Product

Specimens were visually examined for evidence of physical damage detrimental to product performance.



## 1. はじめに

### 1.1 目的

本試験は New Metal-Shell Micro Circular Connector の製品規格 108-78967 Rev.A に規定された性能必要条件に合致しているか確認するために行われた。

### 1.2 適用範囲

本報告書は New Metal-Shell Micro Circular Connector の電氣的、機械的及び耐環境性能の必要条件について行なった試験内容を記述している。

### 1.3 結論

パラグラフ 1.5.に記載されている New Metal-Shell Micro Circular Connector は、該当の製品規格 108-78967 Rev.A の電氣的、機械的、環境性能の必要条件に合致していた。

### 1.4 製品の説明

本製品は、主に耐久性と信頼性が重視される産業、一般商用、軍事用に使用される。シェルサイズは、14ピンが M15、30ピンが M22、それぞれ信号系、パワー系の混合コンタクト構成となる。

コネクタの防水性能は IP67 レベルであり、接続構成は、ケーブルとケーブル、ケーブルとパネル、ケーブルと基板で利用する。

プラグとレセのソルダーカップには、下記のケーブルサイズが接続可能である。

- 14ピン : 信号系=24AWG (19 ストランド)  
          パワー系=20AWG (19 ストランド)
- 30ピン : 信号系=24AWG (19 ストランド)  
          パワー系=22AWG (19 ストランド)

## 1.5 試料

試料は現行の生産システムから無作為抽出法により取り出された。以下の試料が試験に使用された。

型番	品名
2201481-1, -2	Bayonet 14P Plug Pin Socket Connector / Solder Cup Cont KIT
2201482-1	Bayonet 14P Rece Pin Socket Connector / Solder Tail Cont KIT
2201712-1, -2	Thread 30P Plug Pin Socket Connector / Solder Cup Cont KIT
2201713-1	Thread 30P Rece Pin Socket Connector / Solder Tail Cont KIT

附表 1

## 1.6 試験環境

特に条件を示さない場合は下記の試験環境を標準とする。

- 温度 15 ~ 35°C
- 湿度 25 ~ 75%

1.7 製品認定試験の試験順序

試験項目	試験グループ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	試験順序 (b)									
製品の確認検査	1,8	1,4	1	1	1	1	1	1	1	1
接触抵抗 (ローレベル)	2	2	2,4					2,4		2,4
絶縁抵抗				2,6						
耐電圧				3,7						
勘合シェル間の伝導性	3,9									
遮蔽効果						2				
半田濡れ性 (ディップテスト)					2					
挿抜耐久性	6						3			
正弦波振動	4									
衝撃	5									
耐寒性								3		
高温耐久性		3								
熱衝撃				4						
温湿度サイクル				5						
防水性							2,4			
加圧密閉性 (気密性)									2	
混合ガス			3							
塩水噴霧	7									
温度上昇										3
最終製品確認	10	5	5	8	3	3	5	5	3	5

Fig. 2

注記

(a) 欄内の数字は試験を実施する順序を示す。

## 2. 各試験の結果

### 2.1 製品の確認(全試験グループ)

全ての試料は通常生産品のロットより提供された製品にて行われた。全ての試料は目視にて検査され、製品ダメージ及び製造工程異常は確認されなかった。証左として品質部署よりの確認書面が発行されている。

### 2.2 接触抵抗値(ローレベル) (試験グループ 1,2,3,8)

全ての試料において 100mA、20mV を印加した際、コンタクトの接触抵抗値は 30mΩ 以下であった。

### 2.3 絶縁抵抗(試験グループ 4)

全ての試料において試験前の絶縁抵抗値が 5000MΩ 以上、テスト後の測定にて 1000MΩ 以上を確認した。

### 2.4 耐電圧(試験グループ 4)

全ての試料において高圧印加に対してブレイクダウン、フラッシュオーバーの事象は確認されなかった。

### 2.5 電気伝導性(シェル間)(試験グループ 1)

全ての試料において電圧降下が 20mV 以下であった。

### 2.6 遮蔽効果(試験グループ 6)

放射線の減衰は 30dB 以上を確認した。

### 2.7 半田濡れ性(ディップテスト)(試験グループ 5)

半田濡れ部分は最低でも 95%以上が適正に半田濡れしていた。

### 2.8 挿抜耐久性(試験グループ 1,7)

2000 回の挿抜テスト後の結果、全ての試料においてダメージの確認はされなかった。

### 2.9 正弦波振動(試験グループ 1)

振動試験中の接触部の不導通は検知されなかった。振動試験後の試料においてクラック、破損、部品の緩みなども確認されなかった。

#### 2.10 衝撃 (試験グループ 1)

衝撃試験中の接触部の不導通は検知されなかった。衝撃試験後の試料においてクラック、破損、部品の緩みなども確認されなかった。

#### 2.11 耐寒性 (試験グループ 8)

マイナス 55°C の環境に放置後の結果、全ての試料において異常は見られなかった。

#### 2.12 高温耐久性 (試験グループ 2)

所定の時間高温状況に放置した試験の結果、全ての試料において異常は見られなかった。

#### 2.13 熱衝撃 (試験グループ 4)

熱衝撃試験後、全ての試料において異常は見られなかった。

#### 2.14 温湿度サイクル (試験グループ 4)

温湿度サイクル試験の結果、全ての試料において異常は見られなかった。

#### 2.15 防水性 (試験グループ 7)

浸水試験の結果、全ての試料において漏水の痕跡は確認されなかった。

#### 2.16 加圧密閉性 (試験グループ 8)

シェル内に所定の圧縮空気を挿入した結果、全ての試料において気体の漏れは見られなかった。

#### 2.17 混合ガステスト (試験グループ 3)

所定の混合ガス中に放置後の結果、全ての試料において異常は見られなかった。

#### 2.18 塩水噴霧 (試験グループ 1)

塩分 5% の環境に放置後の結果、全ての試料において腐食の痕跡は無かった。

#### 2.19 温度上昇テスト (試験グループ 10)

パワー系端子に規定電流を流し温度上昇を測定した結果、温度は規格値以内であった。

## 2.20 最終製品確認 (全試料)

全ての試験後、試料を最終目視確認したが、いずれの試料にも製品ダメージの痕跡は確認されなかった。又、機能も全て正常が確認された。

## 3. 試験方法

### 3.1 製品の確認検査

本試験に供された試料は本製品の要求仕様に基づいて生産、検査が行なわれたことが確認された物で、通常のラインで生産されたものである。

### 3.2 接触抵抗 (ローレベル)

LLCR の計測は4端子法での計測である。  
試験電流値は最大 100mA、最大 20mV の印加にて計測。

### 3.3 絶縁抵抗

絶縁抵抗値の測定は嵌合状態にて隣接しているコンタクト間の抵抗値の測定である。試験電圧は 500V DC を 2 分間印加して抵抗値を測定する。

### 3.4 耐電圧

耐電圧試験の測定は嵌合状態にて隣接したコンタクト間に 500V AC を 1 分間印加して測定する。

### 3.5 嵌合シェル間の導通性

嵌合した状態のコネクタシェル間の電圧降下を測定する。  
印加電流は  $1.0 \pm 0.1$  A DC @1.5V

### 3.6 遮蔽効果

遮蔽されていないケーブルに 200MHz から 1GHz を励起し放射状況を測定し、その後同様の試験をジャケット付、シールド付ケーブルをプラグに結線した状況で行い、その差を遮蔽性とし dB であらわす。

### 3.7 半田濡れ性 (ディップテスト)

密閉されたコンテナ内にて脱イオン化された沸騰水の上 50.8mm に 8 時間蒸気にさらした後、室温状態にて不活性液化ロジンに 5~10 秒間漬け液から上げて 5~20 秒間余分なロジン液を落とす。  
試料をディップマシンに取り付け、 $245^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  に保たれた半田槽 (60Sn 又は 40Pb) に試料の全面が浸かるまで約 2.5cm/1 秒間の速度で浸水させる。試料を半田槽の中に 4~5 秒間漬け約 2.5cm/1 秒間の速度で槽から出す。濡れ性の検査は IPA に 5 秒間漬けて洗浄した後、倍率 10 倍の顕微鏡にて行う。

### 3.8 挿抜耐久性

2000 回の挿抜を繰り返す。  
挿抜の頻度は 500 回/時とする。

### 3.9 正弦波振動

嵌合したコネクタに 1.52mm の振幅で、10-55-10Hz に毎分 1 サイクルの割合で変化する掃引振動を直行する三方向軸に 2 時間ずつ与えること。

振動中 100mA DC を印加し 0.1  $\mu$  sec. をこえる不連続導通を生じないこと。

追加テスト(ピンソケットコンタクトタイプのみ)として、1.52mm の振幅で、10-2000-10Hz に毎分 1 サイクルの割合で変化する掃引振動を直行する三方向軸に 4 時間ずつ与えること。

### 3.10 衝撃

嵌合したコネクタに正弦半波の衝撃パルスを加速度 490m/秒(50G)速度変化 3.4m/秒、速度時間 11m 秒にて X,Y,Z 軸正逆方向に各 3 回、合計 18 回の衝撃を与え、衝撃中 100mA DC を印加し 0.1  $\mu$  sec. をこえる不連続導通を生じないこと。

### 3.11 耐寒性

挿抜を 10 回行った後、嵌合した試料を $-55^{\circ}\text{C}$ の環境に 96 時間放置する。

### 3.12 高温耐久性

挿抜を 10 回行った後、嵌合した試料を  $150^{\circ}\text{C}$  の環境に 500 時間保つ。

### 3.13 熱衝撃

嵌合したコネクタに $-55^{\circ}\text{C}/30$ 分、 $120^{\circ}\text{C}/30$ 分を 1 サイクルとし、5 サイクル行う。尚、低温高温の切り替えは 1 分以内に行う。

### 3.14 温湿度サイクル

嵌合したコネクタを高湿度(80-98%)の環境に 24 時間放置する。放置中温度を下限  $25^{\circ}\text{C}$  と上限  $65^{\circ}\text{C}$  とに変化させ、この温度変化を 2 回行う。この 24 時間を 1 サイクルとし、10 サイクル行う。

### 3.15 防水性

嵌合状態及び非嵌合状態の試料を水深 1 メートルに 30 分浸水し漏水の痕跡を確認する。

### 3.16 加圧密閉性(気密性)

非嵌合状態のコネクタケーブル端面より  $14.7\text{kPa}$  ( $0.15\text{kgf}/\text{cm}^2$ ) の圧縮空気を 30 秒間送入しシエルからの気体の漏れを確認する。

### 3.17 混合ガス クラスⅡA (4種混合)

嵌合した試料を10回挿抜した後、クラスⅡAの流動している混合ガス中に20日間放置する。混合ガスは温度30℃、湿度75%としCl<sub>2</sub>が10ppm、NO<sub>2</sub>が200ppm、H<sub>2</sub>Sが10ppm、SO<sub>2</sub>が100ppmを含んだガスである。

### 3.18 塩水噴霧

嵌合した試料を5%の塩分水を噴霧した環境に120時間晒す。環境温度は35℃ +2/-3℃とし、塩分溶液の酸性は6.5~7.2 pHとする。

### 3.19 温度上昇テスト

規定又は定格電流を通電して、温度上昇を測定する。上昇温度は30℃以下とする。

### 3.20 最終製品確認

製品にダメージが無いか、機能に不具合が無いかを目視にて検査する。